

株式会社アドバンテスト

2022年3月期(2021年度)第2四半期決算説明会 質疑応答要旨

2021年10月28日(木)

- Q: 事前の想定を大幅に上回る2Q受注高となったが、何がこの上振れを牽引したのか確認したい。また下期も高水準な受注を見込んでいるようだが、テスト市場においてどのような構造変化が起こっているかも確認したい。
- A: 2Q受注高における予想と実績の差異は、全社受注で1,050億円上振れ。内訳としては、SoCテストで880億円、メモリ・テストで30億円、メカトロニクスで100億円、サービス他で40億円。
- 最も上振れたSoCテストにおいて受注増の要因となったのは、半導体逼迫に対する生産能力強化の動き、当社製品のリードタイム長期化、来年以降も微細化が進むアプリケーション・プロセッサ(APU)/ハイ・パフォーマンス・コンピューティング(HPC)向けの需要増の3点と捉えている。
- 2Qの受注水準が今後も継続するとは予想していないが、今回提示した下期受注高予想2,000億円は、四半期受注高1,000億円の水準となる。過去の趨勢と比べると、高い受注レベルが継続すると考えている。
- Q: 経済安全保障の恩恵に関して質問したい。今後、テストの顧客となるOSAT企業が米国、欧州、日本でどんどん拠点を建設することでテスト需要が喚起されるのではないかと期待している。この点に関して御社の見方を確認したい。
- A: 短期的には、サプライチェーン多重化は追い風になると見込んでいる。ただし、経済安全保障強化を理由に世界中でテストキャパシティが増強された後、自由化への回帰など逆の流れが起こった場合は過剰能力化してしまう可能性もある。今後の業界動向には注意を払っていく。
- Q: 下期受注予想2,000億円について、事業別の詳細をお願いしたい。また、3Qと4Qの受注の強弱バランスも確認したい。
- A: 3Qと4Qの受注高構成比は、下期予想2,000億円を半分ずつにしたイメージ。しかし、4Qについてのビジビリティが高まるにはもう少し時間を要する状況。事業別の傾向については、SoCテスト、メカトロニクス、サービス他は上期に対し下期は減少方向で、メモリ・テストについては上期比フラット、という見立て。
- Q: 今般計画されている米アリゾナ州での生産能力拡大やR&D Altanova社の買収を通じて、米国MPUメーカーとの距離感が縮まり、彼らとのテストビジネスが拡大する可能性はあるか。

A: 個別顧客とのビジネス状況に関する明確な回答は控えたい。当社としてはどの顧客であれ、様々な切り口から顧客価値の拡大に常に努力しており、消耗品ビジネスもそのような機会の一環。

Q: 下期は上期比増収を計画しているが、2Qで売上予想に対する未達要因となった物流の混乱は一過性の下押し要因と捉えてよいか。

また、21年度末の受注残予想 2,738 億円から、22年度の売上高は 4,000 億円を優に超える水準が見込まれるが、ESMの活用を含め、御社の生産能力や売上の上方弾力性に問題がないかを確認したい。

A: 2Qで起きた物流の混乱は、9月中旬に中国・台湾エリアで台風によるフライトキャンセルが発生したことに起因している。下期も継続するものではなく、一時的な要因であったと考えている。

生産キャパシティについては、四半期売上高 1,200 億円程度、通期で 5,000 億円弱の能力を確保できていると考えているが、部品調達面には懸念がある。当社がテストを作るには、自動車の 10 倍程度に相当する 50 万点の部品が必要で、急峻な受注増加への追従に非常に苦心している。部品確保に向けては、当社の顧客でもある半導体メーカーに対し、半導体の生産能力を上げるためにもまずは半導体テスト用の部品を優先供給していただけるようお願いしている。

Q: どのくらい先の生産分まで部品は確保できているか。

A: 今回発表した通期 4,000 億円の売上予想は、当然達成するという意思のもとの数字である。2022 年度半ばまでには半導体不足は徐々に解消するのでは、という見方もあるようだが、実際のところ状況は日々流動的であり、当社としては今後を楽観視できるほどの確信を得ていない。

Q: 今回の SoC テスタ受注の大幅上振れの背景について、その詳細を確認したい。半導体の高性能化や微細化がテスタ需要を牽引しているということだが、具体的にどのような技術変化が需要を押し上げているのか、解説をお願いしたい。

A: 足元の SoC テスタのビジネスにおいては、先端プロセスへの移行が進んでいる APU、HPC/AI デバイスが力強いドライバーになっている。米国のファブレス企業や台湾のファウンドリ企業が、当社の先端プロセス品向けのビジネスを牽引している。

近年毎年計画されている先端プロセスへの移行は、トランジスタ数の継続的な拡大を通じてテストタイムの長時間化を促し、テスタ需要の伸びを支えているが、このトレンドは当分続くと考えている。

それに加えて、今後 2~3 年の間に、現行の FinFET に代わる新たなトランジスタのアーキテクチャーが採用されていく。新たなアーキテクチャーを導入する際は、顧客はどのような特性で動

作するか、信頼性担保のための評価を今まで以上に入念に行う必要がある。このこともデバイスの品質を担保する設備を扱う当社にとっての追い風となると考えている。

Q: 3Q 受注予想のビジビリティについて確認したい。3 か月前に出された 2Q 受注予想は、結局大きく乖離して着地した。同様の可能性が今回の 3Q 予想にも起こりえるか。あるいは先行発注の動きが沈静化したなどで、3Q の受注予想は従前よりビジビリティが高いのか。

A: 2Q 受注を予想した際に読み切れなかったのは、顧客が半導体装置市場環境を考慮し、従来より遠い需要時期の案件まで早めに発注に踏み切った比率が高かったこと。しかしその動きは落ち着きつつある。顧客は今は、当社製品の現状のリードタイム約6か月を前提に、彼らの生産計画に沿ったテスト発注を行うようになりつつある。それを踏まえると、今回の 3Q 受注見通しはそれほどブレないのではないかと考えている。一方で、顧客の 2022 年下期の生産計画の具体化が途上であることから、4Q 以降の受注見通しの精度については限りがある。

Q: HPC 向けデバイス市場では、既存の大手米国ファブレス以外に、新たなプレイヤーがかなりの数参入していると思われる。そうした新規参入者向けの競争状況や競合との差別化要素を確認したい。

A: 過去はゲーミング用途が主体だった HPC デバイスだが、近年はデータセンター向けなど、用途が拡大している。それに呼応してエマージングプレイヤーが米国やその他の地域で登場してきているが、彼らに対して当社は非常に強いポジションを取れている。

これは、大手顧客との深いエンゲージメントにより、HPC 向けテストで高い知見を蓄積してきたことが実ったことによる。

また、彼らとのエンゲージメントは、V93000 EXA Scale™という SoC テスタの新製品に将来の HPC テストに有用な技術を搭載することにもつながっている。そのことも、差別化要素となる。これらから、HPC/AI 分野が今後ますます伸びていく中、過去から有してきた非常に高い市場シェアを継続できると見込んでいる。

Q: 下期の営業利益率は 27.1%を予想しているが、来年度は SoC テスタの伸びによって製品ミックスのさらなる良化が期待される。今後の営業利益率の考え方を確認したい。

A: 下期の営業利益率予想は、足元の部材コストの上昇影響と成長投資の影響を織り込んで算出したもの。営業利益率に関しては当然改善を今後目指していくが、一方で M&A、人材補強、設備投資といった先行投資も着実に実施していく。年間売上高が 4,000 億円を超えてくるようであれば条件は変わるが、4,000 億円レベルであれば、今下期の見込みが現実的な営業利益率の水準ではないかと考えている。

Q: 半導体の値上がりが原価に悪影響を及ぼすケースが他の企業でかなり見受けられる。御社の場合、コスト面において過度な懸念は不要であるか。

A: 顧客である半導体メーカーが、サプライヤーとして当社に対する半導体販売価格を上昇させてくるとなると、当社製品の販売価格も上昇することになる。その意味では当社には交渉力があることになる。ただそれよりも、調達面における一番の問題は、当社は自動車メーカーのような大口ユーザーではないので、半導体メーカーから供給を後回しにされがちであること。そのため、当社に半導体を優先供給することがボトルネックの早期改善につながり、またその逆の場合は半導体不足がなかなか解消されないこととなる、という構図を顧客に示し、当社に対する供給優先度を高めていただけるよう取り組んでいる。

以上

※本資料に記載されている内容は、決算説明会の質疑をもとに当社の判断で要約したものです。また本資料には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。